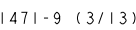


TE CONNECTIVITY



4		3		2		1	
© 2021 TE Connectivity. All Rights Reserved.				REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
	-	SEE SHEET 1		-	-	-	
NOTES:							
1 AT AREA F MIN 0.8 µm GOLD OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N; AT AREA C 3.0 -6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL				1 IM BEREICH F MIN. 0.8 µm GOLD ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N; IM BEREICH C 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL			
2 PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB REQUIREMENTS FOR PCB HOLE				2 EINPRESSZONE FÜR 1.6mm LEITERPLATTE ANFORDERUNG AN DIE LEITERPLATTENBOHRUNG			
PLATED HOLE: DRILL-Ø: 1.0 ±0.025 Cu-THICKN.: 25 - 50 µm Sn-THICKN.: 4 - 10 µm FINISHED HOLE-Ø: 0.9 ±0.07				PLATTIERTES LOCH: BOHR-Ø: 1.0 ±0.025 Cu-DICKE: 25 - 50 µm Sn-DICKE: 4 - 10 µm FERTIGLOCH-Ø: 0.9 ±0.07			
UNPLATED HOLE: DRILL-Ø: 1.0 ±0.025 FOR SOLDER APPLICATION				NICHT PLATTIERTES LOCH: BOHR-Ø: 1.0 ±0.025 ZUM LÖTEN			
ALTERNATIVE-PLATING: Cu-THICKN.: 25 - 50 µm Ni-THICKN.: 1.3 - 5 µm Au-THICKN.: 0.05 - 0.2 µm				ALTERNATIV-PLATING: Cu-DICKE: 25 - 50 µm Ni-DICKE: 1.3 - 5 µm Au-DICKE: 0.05 - 0.2 µm			
93 REEL UNIT 50.000 PIECES. REEL-Ø 600mm / Ø588mm REEL THICKNESS SEE TABLE				93 ROLLENEINHEIT 50.000 STIFTE. ROLLEN-Ø 600mm / Ø588mm ROLLENDICKE SIEHE TABELLE			
4 SOLDERABILITY ACC. TO IEC 60068 - 2 - 20; TEST Ta				4 LÖTBARKEIT NACH IEC 60068 - 2 - 20; PRÜFUNG Ta			
5 AT AREA N 3.0-6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL				5 IM BEREICH N 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL			
6 AT AREA F 1-2 µm TIN; AT AREA C 3.0-6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL				6 IM BEREICH F 1-2 µm ZINN; IM BEREICH C 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER JE MIN. 1.2 µm NICKEL			
157 CUT AREA FOR LOOSE PIECE PARTS DURING THE STITCHING INTO PCB DIMENSION IS DETERMINED BY THE TOOL OF THE STITCHING MACHINE				157 SCHNITTSTELLE FÜR EINZELSTIFT BEIM EINSETZEN IN PCB MAß IST DURCH WERKZEUG AN DER JEWELIGEN EINSETZMASCHINE VORGEGEBEN			
8 1000 PIECES ARE PACKED INTO SHOCK-PROOF BOX AND CLOSED WITH COVER				8 1000 STIFTE IN STOßSICHERE SCHACHTEL VERPACKT UND MIT DECKEL VERSCHLOSSEN			
10 AT AREA N MIN. 2.5 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL				10 IM BEREICH N MIN. 2.5 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL			
12 AT AREA N 1-2 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL				12 IM BEREICH N 1-2 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL			
13 AT AREA F 2-4 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N; AT AREA C MIN. 1.2 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL				13 IM BEREICH F 2-4 µm ZINN ÜBER 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N; IM BEREICH C MIN. 1.2 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL			
14 AT AREA F MIN 0.8 µm GOLD OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N; AT AREA C 1.3-2.5 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL				14 IM BEREICH F MIN. 0.8 µm GOLD ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N; IM BEREICH C 1.3-2.5 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL			
17 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI				17 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI			
18 OBSOLETE				18 OBSOLETE			
19 AT AREA F MIN. 1.2 µm GOLD OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N; AT AREA C 1.3-2.5 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL				19 IM BEREICH F MIN. 1.2 µm GOLD ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N; IM BEREICH C 1.3-2.5 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL			
20 AT AREA F 1.5-5.0 µm SILVER (WEIGHT% ≥98.0) OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N AT AREA C 3.0-6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL				20 IM BEREICH F 1.5-5.0 µm SILBER (GEWICHT% ≥98.0) ÜBER MIN 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N; IM BEREICH C 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL			
21 PACKED ON PLASTIC REEL				21 VERPACKT AUF PLASTIKHASPEL			
22 PACKED ON CARDBOARD REEL				22 AUF KARTONROLLE VERPACKT			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-928776-2](#)